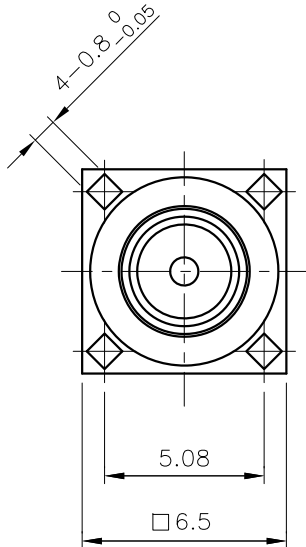
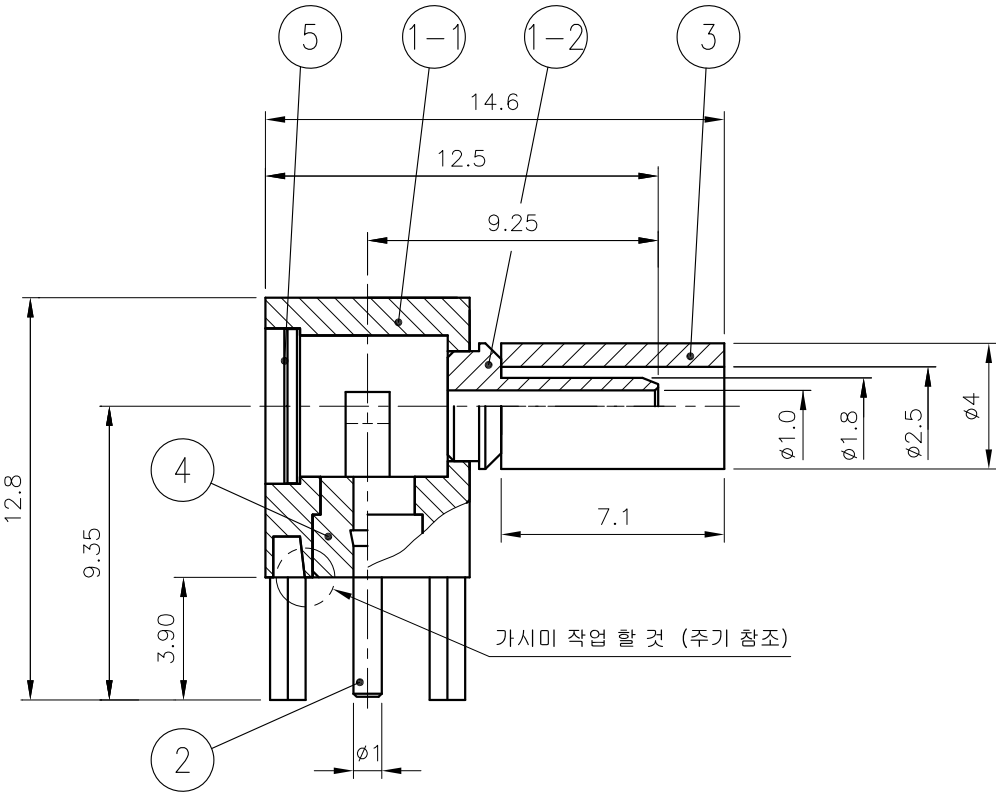




조립 주기

- 2번 CONTACT와 4번 INSULATOR를 조립 한다.
- 1번 BODY에 위 조립 품을 삽입 후 가시미 작업을 한다.
- 5번 COVER는 조립 하지 않으며, 별도 포장 한다.

REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration			1997. 05. 06.
1	[설번처리 NO.201207-0005] BODY+COVER 조립부 치수 변경	I.C.KIM	I.C.KIM	2012. 07. 20.
2	[설번처리No. 202205-0004] (은택 작업시 날이 들어간 공간 및 원형 바디가 올라와서 개선)	S.H.KIM		2022. 05. 25.

주 기

1. 재질

- 1.1 몸체 : KS-D-5101 C3604BD-F 패삭황동봉
- 1.2 접촉핀 : KS-D-5101 C3604BD-F 패삭황동봉
- 1.3 절연체 : SAE-AS1946 또는 동등한 재료 (PTFE 테프론)

2. 보호피막처리 : 접촉핀은 MIL-DTL-45204, type II, class I

몸체는 MIL-DTL-45204, type II, class 00에 따라 처리 할 것

3. 전기적특성

- 3.1 특성 임피던스 : 50Ω
- 3.2 온도 범위 : -65°C ~ +165°C

4. SUHNER (스위스) 사의 부품번호 86 SMC-50-1-2 또는 동등 이상품.

5. 모든 치수는 참고 치수임

1	5	COVER	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate	DCO00096-5/1 DCO00033-5/1
	4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00015-N/1
	3	FERRULE	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate	DFE00019-5/1
	2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate (1.27μm)	DCT00022-5/1
	1-2	BODY (B)	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate	DBD01278-3/1
	1-1	BODY (A)	1	MBsBD C3604BD-F	(0.508μm)	DBD01439-3/1
	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ±0.2	DATE 2022. 05. 25.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	Angle ±1°	APPROVED BY					
MATERIAL _____	CHECKED BY			TITLE MCX50-L-4R-C-178			
	DRAWN BY S.H.KIM						
FINISH _____	SCALE 4/1	UNIT mm		A4	DWG NO. CN01142-7/1 (K313-989-000)		
					REVISION 2	SHEET 1 of 1	